



[kingston.com/emcp](http://kingston.com/emcp)

## eMCP

# Енергоефективне інтегроване сховище для компактних мобільних пристроїв, IoT-пристроїв та вбудованих рішень

Kingston пропонує лінійку стандартних (JEDEC) eMCP-компонентів. eMCP поєднує в одному компактному корпусі сховище Embedded MultiMedia Card (eMMC) та оперативну пам'ять LPDDR DRAM, упаковані за технологією Multi-Chip Package (MCP). Таке рішення забезпечує кращу інтеграцію та зменшує загальний розмір. eMCP — це ідеальне рішення, що поєднує сховище та пам'ять, для таких компактних пристроїв, як смартфони, планшети, пристрої, що носяться та різні пристрої Інтернету речей (IoT).

## ОСОБЛИВОСТІ

- Рішення на NAND флеш-пам'яті, яке завдяки стандартному інтерфейсу eMMC полегшує розробку та супровід продукції. Це дозволяє значно зменшити складність розробки та цикл сертифікації продукції.
- Високоінтегрована комбінація пам'яті та сховища робить eMCP ідеальним вибором для пристроїв із малим форм-фактором.
- DRAM-пам'ять дозволяє зменшити споживання енергії, тому eMCP є ідеальним рішенням для таких пристроїв, що працюють на акумуляторах, як пристрої, що носяться та мобільні IoT-пристрої.
- Зменшення складності переліку компонентів та зменшення кількості компонентів в пристрої.
- Доступні різні варіації прошивки, які дозволяють підібрати оптимальний варіант щодо продуктивності, енергоспоживання та ресурсу.

## СЕГМЕНТИ РИНКУ



Смартфони та Планшети



Пристрої, що носяться



AI акселератори



Інтернет речей (IoT)

## АРТИКУЛИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### eMCP на базі LPDDR3

Артикул	Ємність		Стандарт		Корпус	FBGA	Робоча температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C — +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C — +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C — +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C — +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C — +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C — +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C — +85°C

### eMCP на базі LPDDR4x

Артикул	Ємність		Стандарт		Корпус	FBGA	Робоча температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C — +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C — +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C — +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C — +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C — +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C — +85°C

